



第十五屆世界電子電路大會(ECWC15)

會議日程表

第一天：2020年11月30日(星期一) - 香港

時間	会议		
9:00-9:30 am	欢迎词		
9:30-10:15 am	主题会议 (K1) 电路板发展历史及技术趋势 中原捷雄博士 - President of N.T. Information Ltd.		
10:15-11:00 am	主题会议 (K2) VeCS: HDI 和通孔技术的下一代 3D 互连 Happy Holden 先生 · I-Connect007, PCB007 杂志技术咨询编辑		
11:00 - 11:45 am	主题会议 (K3) 汽车用自适应 PCB 设计 谭少濂先生 - 罗伯特·博世有限公司		
11:45 - 12:00 pm	休息		
12:00 - 12:30 pm	论文 S01 探讨线路板行业机械加工废弃材料回收技术 许校彬先生 惠州特创电子有限公司	论文 S02 一种创新高精度的阻抗模拟方法·应用于所有特定叠构电路板设计 何洪先生 中国电子科技大学	论文 S03 选择应用在 77/79 GHz 安全和可靠性产品,射频基材的电气和机械可靠性的关键要求 Mr Manfred Huschka AGC 多材料部门
	论文 S04 焊锡复合材料·多功能热界面材料解决方案 Mr Ning-Cheng Lee 钢泰科技	论文 S05 一种用于玻璃和金属表面的新型憎水剂 中島 伸一郎先生 日本航空电子工业株式会社	论文 S06 5G 应用的有机复合材料的开发 Ms Misato Takemura 太阳油墨有限公司
1:00-2:15 pm	午饭		
2:15-2:45 pm	论文 S07 5G PCB 技术要求与挑战 高峰先生 华为技术有限公司	论文 S08 硅基板上氮化镓高压器件组装新方法 Ms Hsinjou Lin 硅品精密工业股份有限公司	论文 S09 电源电池模块用铝基 PCB 关键技术研究 张长明先生 深圳市博敏电子有限公司
	论文 S10 高速信号传输线损耗的研究 张灵子女士 中国电子科技集团公司第五十二研究所	论文 S11 调整剂对化学镀铜沉积特性的影响 刘金峰先生 深南电路有限公司	论文 S12 应用于高速板 Skip Via 制造工艺的研究 向参军先生 广合科技(广州)有限公司
3:15-3:45 pm	论文 S13 高阶 HDI PCB 方凹(Cavity)的技术开发 孙睿先生 珠海方正 PCB 发展有限公司	论文 S14 使用传统锣机加工 LED 灯载板 周军林先生 江西志浩电子科技有限公司	论文 S15 TDR 测量特性阻抗的误差分析及 CPCA 标准制定中的技术考虑 曹勇先生 中国电子科技大学
	论文 S16 如何有效验证电子产品蠕变腐蚀失效的发生? Mr Dem Lee 综合服务技术股份有限公司	论文 S17 可靠的无钎活化化学镀铜工艺 Mr Pentel Yu Atotech 台湾有限公司	论文 S18 防止多层印刷电路板"大拼板设定"在制造过程中局部变形 陈世金先生 博敏电子有限公司
4:15-4:30 pm	休息		
4:30-5:00 pm	论文 S19 PTFE 混压印制电路(通孔和盲孔)制造技术研究 周国云先生 中国电子科技大学	论文 S20 高阶 HDI 印制线路板制造关键技术综述 陈世金先生 博敏电子有限公司	论文 S21 新型黑氧化物应用在铜直接激光钻孔 中村 惟之先生 Meltex 株式会社
	论文 S22 用于高频印刷电路板生产的增强附着力的体系 Dr Thomas Thomas Atotech 德国公司	论文 S23 汽车 BMS 采集线束和聚乙烯萘二甲酸酯材料应用的开发 张明明先生 安捷利电子实业有限公司	论文 S24 压力感测模块的开发 郭好永先生 安捷利电子实业有限公司
5:00-5:30 pm	论文 S25 应用蚀刻化学添加剂生产高蚀刻因子导线 Dr Chul Lee 华标工程有限公司	论文 S26 表面处理对 5G 高速印刷电路板信号完整性的影响 高亚丽女士 珠海方正 PCB 发展有限公司	论文 S27 开路下铜表面添加剂对流有关竞争性竞争吸附的研究及其在 PCB 电镀铜填孔中的应用 朱凯博士 深南电路有限公司



第十五届世界电子电路大会(ECWC15)

会议日程表

第二天: 2020年12月1日(星期二) - 香港

時間	会议		
9:00 - 9:45 am	主题会议 (K4) 5G 技术和材料的挑战 姜旭高博士 - <i>Managing Partner of Prismark</i>		
9:45 - 10:30 am	主题会议 (K5) 智能 PCB 技术 孙耀峰博士 - <i>香港应用科技研究院有限公司高级经理</i>		
10:30 - 11:15 am	主题会议 (K6) 工业互联网 . 基于实际生活安装犯错和经验教训 杉山 素先生 - <i>三菱电机株式会社工业互联网推广高级经理</i>		
11:15 - 11:30 am	休息		
11:30 - 11:45 am	问答环节 1	问答环节 2	问答环节 3
11:45 - 12:00 pm	问答环节 4	问答环节 5	问答环节 6
12:00 - 12:30 pm	论文 S28 系统封装的 5G EMI 屏蔽组装方案 蘇柏元先生 硅品精密工业有限公司 (SPIL)	论文 S29 用于医学图像分割的嵌入式深度学习界面平台 Dr Yu-Jung Huang 台湾义守大学	论文 S30 3D 印刷电路板的可靠性和挑战分析 陈黎阳先生 广州兴森快捷电路科技有限公司
12:30 - 1:00 pm	论文 S31 更弹性 . 数字化 Dr Rudy Coquet 爱克发·吉华集团	论文 S32 阻焊喷墨印刷技术在电路板制造中的应用研究 李铁先生 东莞市五株电子科技有限公司	论文 S33 先进的水平化学镀铜技术 李晓红博士 广东天承科技有限公司
1:00 - 2:15 pm	午饭		
2:15 - 2:45 pm	论文 S34 应用在 5G 通信的创新单一 TGV 玻璃天线制造技术 張佑祥先生 台湾工业技术研究所 (ITRI . 台湾)	论文 S35 新一代线路板,可靠的无镍表面处理技术- 5G, HDI, 射频微波 . 高频率 Dr Kunal Shah LILOTREE	论文 S36 适用于高频印制电路减少信号损失的基于锡/硅烷改性的高结合力表面处理方法 李浩霖先生 重庆方正高密电子有限公司
2:45 - 3:15 pm	论文 S37 温度对电路板传输线信号完整性的影响 叶晓菁女士 深南电路有限公司	论文 S38 5G 通信印制电路板结构设计、模拟和信号完整性测试的案例 陈苑明博士 中国电子科技大学	论文 S39 用于可穿戴储能衣物的可拉伸 Ni@NiCoP 纺织品研究 孙鹏博士 中山大学
3:15 - 3:45 pm	论文 S40 先进的印刷电路板技术应用在太空产品及最新标准的评估 Mr Stan Heltzel 欧洲太空总署	论文 S41 应用于自助充电的整体式光催化燃料电池的平面印刷微型超级电容器的研究 孙鹏博士 中山大学	论文 S42 探讨当前形势下电路板制造商维持可持续利润的经营和管理方案 陈波先生 江西志浩电子科技有限公司
3:45 - 4:15 pm	论文 S43 韩国 PCB 产业的现状 Dr Minsu Lee 韩国电子封装及电路协会	论文 S44 印刷电路板行业中应用的创新工业节水技术 赖强先生 广州捷骏电子科技有限公司	论文 S45 IPC 安全物资供应网络 (基于区块链匿名的) Mr Radu Costin Diaconescu Swissmic SA
4:15 - 4:30 pm	休息		
4:30 - 5:00 pm	论文 S46 IPC CFX 标准-基于 IIoT 广泛的互操作性 Mr Michael Ford 英国 Aegis 软件	论文 S47 开发高可靠性创新低温固化正显影光敏聚苯并恶唑 Ms Satomi Fukushima 太阳控股有限公司	论文 S48 开发新的氧化替代工艺 . 以满足 mSAP 生产的高工艺清洁度要求 Dr Thomas Thomas 安美特德国公司
5:00 - 5:30 pm	论文 S49 CCD 钻机应用于背钻工艺 (或背钻技术) 钟根带先生 广合科技(广州)有限公司	论文 S50 5G 高速 PCB 的树脂塞孔设备及质量问题的研究与分享 刘茂林先生 广州捷骏电子科技有限公司	
5:30 - 5:45 pm	问答环节 7	问答环节 8	问答环节 9
5:45 - 6:00 pm	问答环节 10	问答环节 11	问答环节 12



第十五届世界电子电路大会(ECWC15)

会议日程表

第三天：2020年12月2日(星期三) - 深圳

時間	会议
10:00 am	国际电子电路 (深圳) 展览会开幕
10:30 - 10:40 am	欢迎词
10:40 - 11:25 am	<p><u>主题会议 (K7)</u> 5G 发展及其趋势分析 刘哲先生 - 中兴通讯股份有限公司总工程师</p>
11:25 - 12:10 pm	<p><u>主题会议 (K8)</u> 下一代显示器:增强视觉感知的人工智能 俞大海博士 - TCL 工业研究院 (香港) 有限公司总经理</p>
12:10 - 2:00 pm	午饭
2:00 - 2:30 pm	<p><u>金赞助主题会议</u> PCB 制造导通孔黑影工艺应用介绍 黄金先生 - 深圳市贝加电子材料有限公司技术总监</p>
2:30 - 3:15 pm	<p><u>主题会议 (K9)</u> 工业互联网：多维感知与智能控制 崔燦先生 - 微物聯技術(深圳)有限公司首席执行官及创始人</p>
3:15 - 4:30 pm	<p><u>圆桌论坛</u> 5G 发展和对于 PCB 产业带来的变革 主持人：贺俊强先生 - 香港生产力促进局内地附属公司总经理 嘉賓：孙刚先生 - 深圳市晶科鑫实业有限公司董事长 欧凯先生 - 华辰资本执行总裁</p>
4:30 - 5:00 pm	闭幕及颁奖典礼

*第三天的研讨会将移师中国深圳会展中心，与国际电子电路 (深圳) 展览会同步进行。

第十五届世界电子电路大会(ECWC15)

海报论文

海报号	论文议题	论文题目	作者	企业
P-01	材料、组件和可追溯性	应用于高频高速高密度柔性电路板的新一代粘结系统的要求	Mr Genghong Chen	尼关工业有限公司
P-02	制造	Microwave 印刷电路板的技术发展与应用研究	袁欢欣先生	汕头超声印制板公司
P-03	制造	高频高速电路板的开发与应用	袁欢欣先生	汕头超声印制板公司
P-04	制造- 制程研发	埋子板 PCB 工艺优化研究	吴军权先生	金柏泽科技有限公司
P-05	制造- 制程研发	采用 SOC 工艺生产微孔填孔电镀的缺陷分析和改进	刘彬云先生	广东光华科技股份有限公司
P-06	制造- 制程研发	天线面板中使用 PTFE 覆盖膜的工艺技术研究	李恒文先生	深南电路有限公司
P-07	制造- 设备	嵌入式陶瓷 PCB 技术开发	纪成光先生	生益电子有限公司
P-08	产品质量、测试和生命周期管理	HDI 板层压空洞的研究与改进	赵刚俊先生	生益电子有限公司
P-09	产品质量、测试和生命周期管理	嵌入式电阻产品对电阻值影响的研究	杜军先生	东莞市康源电子有限公司
P-10	产品质量、测试和生命周期管理	大型 D 型焊盘加阻焊开窗设计印刷电路板电性能检测技术	聂兴培先生	惠州金柏泽电路科技有限公司
P-11	产品质量、测试和生命周期管理	嵌入分立器元件 PCB 的技术研究	陈丽琴女士	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-12	产品质量、测试和生命周期管理	沉锡过程中锡须生长机理及特征的研究	靳婷女士	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-13	产品质量、测试和生命周期管理	波峰焊焊接工艺锡珠产生的机理研究	邓亚峰先生	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-14	产品质量、测试和生命周期管理	PCB 硬板拉伸强度研究	罗定锋先生	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-15	产品质量、测试和生命周期管理	ENIG 表面处理 PCB 板通孔孔环开裂失效模式原理研究	张雪梅女士	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-16	产品质量、测试和生命周期管理	SMT 工艺流程与 CBGA 混合焊点温度变化失效机理研究	靳婷女士	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-17	产品质量、测试和生命周期管理	镀通孔的电解腐蚀失效机理研究	张雪梅女士	广州兴森快捷电路科技有限公司
P-18	产品质量、测试和生命周期管理	红外光谱在异物分析中的应用	李德英女士	迅达科技
P-19	产品质量、测试和生命周期管理	PCB 嵌入式电感线圈短路检测系统的设计与实现	钟志维先生	广东世运电路科技股份有限公司
P-20	PCB 制程	高压水水流压力对化学镀铜膜 PTH 可靠性和质量的影响研究	李晓红博士	广东天承化学科技有限公司
P-21	PCB 制程 - 化学科技	PTFE 印刷电路板浸银表面处理引发短路机理研究	张健先生	生益电子有限公司
P-22	PCB 制程 - 化学科技	高性能纳米钼胶体在水平 PTH 中的应用	张磊先生	深圳市天熙科技发展有限公司
P-23	PCB 制程 - 化学科技	抗渗添加剂对阻焊喷墨印刷效果的研究	李铁先生	东莞市五株电子科技有限公司
P-24	PCB 制程 - 机械科技	沉头孔控深钻与阶梯孔控深铣的控深原理比较浅析	邹海波先生	奥士康科技有限公司
P-25	能源收集/绿色能源	用藻类系统处理沙田污水	Ms Lili Chen	香港生产力促进局
P-26	先进及新兴技术	等离子在线路板行业的应用前景	陈磊先生	珠海恒格电子科技有限公司
P-27	先进及新兴技术	不同超薄铜箔制作精细线路的研究 (MSAP 工艺)	陈华丽女士	汕头超声印制板公司
P-28	PCB 的 5G 应用要求	5G 射频应用高频 CCL 材料评估 (中国本土供应商)	陈文仁先生	明阳电路有限公司.
P-29	智能生活应用	用于教育的神经科学分析	Mr Qi Zheng	香港大学
P-30	设计和发展工具	远红外磁共振对溶液物理和化学特性的改变	刘东先生	深圳福兴智能技术有限公司